

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有權機關  
國際事務局



(43) 国際公開日  
2005年2月10日 (10.02.2005)

PCT

(10) 国際公開番号

### (31) 國際特許分類<sup>7</sup>:

MOUL. 21/316

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2005/013346 A1

(21) 圖廢出圖番号:

PCT/JP2004/010808

(22) 國際出版日: 2004年7月29日 (29.07.2004)

## (25) 国際出張の言語: 日本語

## 20 國慶公園の言語: 日本語

(30) 終了年データ: 2003年7月31日 (31.07.2003) JP

(71) 出願人(業者を除く全ての指定図について): コマツ  
電子全員株式会社 (KOMATSU DENSHI KINZOKU  
KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒2540014 神奈川県平  
塩市四之宮3丁目25番1号 Kanagawa (JP)

(72) 発明者: および

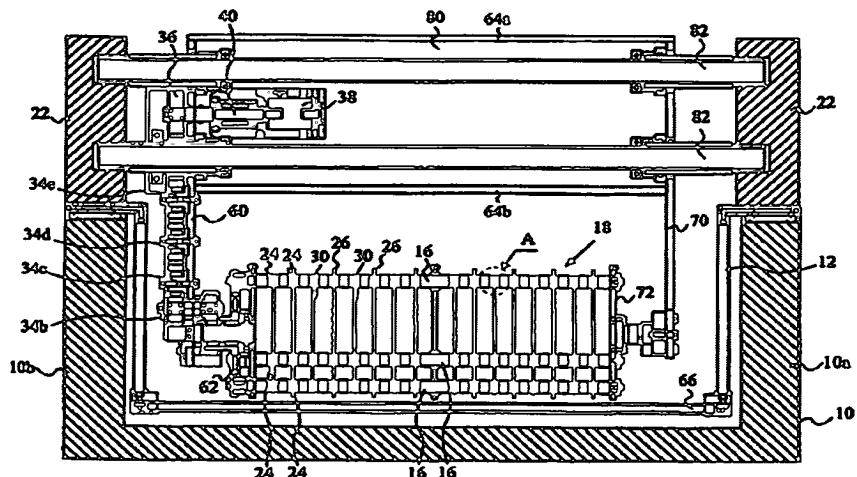
(75) 発明者/出願人(共国についてのみ): 宮崎 正光 (MIYAZAKI, Tadaharu) [JP/JP]; 〒2540014 神奈川県平塚市四之宮3丁目25番1号 コマツ電子金属株式会社内 Kanagawa (JP). 平山 和也 (HIRAYAMA, Kazuya) [JP/JP]; 〒2540014 神奈川県平塚市四之宮3丁目25番1号 コマツ電子金属株式会社内 Kanagawa (JP). 福永 寿也 (FUKUNAGA, Hisaya) [JP/JP]; 〒2540014 神奈川県平塚市四之宮3丁目25番1号 コマツ電子金属株式会社内 Kanagawa (JP). 二村 公男 (FUTAMURA, Hiroyasu) [JP/JP]; 〒2540014 神奈川県平塚市四之宮3丁目25番1号 コマツ電子金属株式会社内 Kanagawa (JP).

(74) 代理人: 木村 高久, 外(KIMURA, Takahisa et al); 〒104-0043 東京都中央区銀1丁目8番11号 千代ビル6階 Tokyo (JP).

〔總卷有〕

(34) Title: METHOD AND APPARATUS FOR ETCHING DISK-LIKE MEMBER

### (34) 発明の名稱: 円板状部材のエッティング方法及び装置



(57) **Abstract:** Disclosed are a method and apparatus for etching disk-like members, especially a method and apparatus for etching semiconductor wafers. In a method wherein wafers (30) are rotated and etched in an etching chamber (12) which is filled with an etching solution, a non-rotating cell plate (26) is disposed between two rotating wafers (30). In an etching apparatus wherein multiple wafers (30) are supported and rotated by a rod (16), a cell plate (26) is disposed between each two wafers (30). The cell plate (26) has a surface area roughly equivalent to that of the wafer (30).

(57) 括弧: 本図発明は、内板状の部材のエッティング方法及びエッティング範囲に係り、特に、半導体ウェーハのエッティング方法及びエッティング範囲に限する。エッティング液を浴にしたエッティング缸(12)の内部で、ウェーハ(

/總覽/